



厦门华联电子股份有限公司

Xiamen Hualian Electronics Corp., Ltd.

产品规格书

SPECIFICATION

产品名称：光电压输出型光耦合器

DESCRIPTION: Photovoltaic MOSFET Driver

产品型号：HPV7A11S

PART NO.: HPV7A11S

拟制 Prepared	审核 Verified	批准 Approved

电话 Tel: 86-0592-2950777

传真 Fax: 86-0592-6037471

网址 Web: www.xmhl.com

地址：厦门市翔安区舂阳南路 189 号

Add: No.189,Fangyang South Road,Xiang'an District,Xiamen China

1 概述 General

光电压输出型光耦合器 HPV7A11S 由砷化铝镓红外发光二极管作为输入级耦合到高电压输出光探测电路，光探测电路由高速光电二极管阵列和驱动电路构成。适用于功率 MOSFET 或 IGBT 的栅极驱动，产品见图 1。

The Photovoltaic MOSFET Driver HPV7A11S consists of a AlGaAs infrared emitting diode input stage optically coupled to a high-voltage output detector circuit. It is capable of directly driving gates of power MOSFETs or IGBTs. Products shown in Figure 1.



图 1 产品 Figure 1-Product

2 特点 Features

- 单通道光伏 MOSFET 驱动输出 Single Channel Photovoltaic MOSFET Driver output;
- 输入、输出端之间绝缘电压高 Isolation voltage between input and output VISO ≥ 3750Vrms;
- 微型单列贴片式 4L 塑料封装 SOP 4L Plastic Package;
- 符合 RoHS 指令最新要求及 REACH 法规最新要求。

Comply with the latest requirements of the RoHS directive and the latest requirements of REACH regulations.

3 应用 Applications

- 给电子电路提供电压源 Supply for electronic circuit;
- 驱动固态继电器 Drive Solid State Relay.

4 电原理图 Schematic Diagram

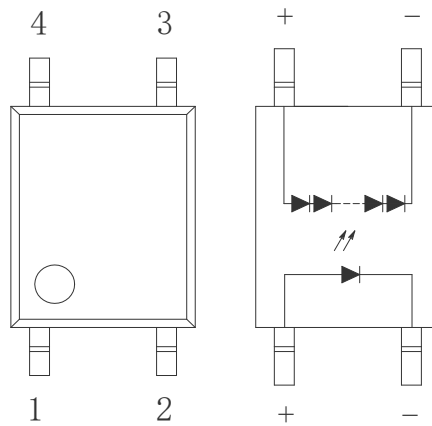


图 2 电原理图 Figure 2-Schematic

5 极限参数 Absolute Maximum Ratings

表 1 极限参数

Table 1-Absolute Maximum Ratings

参数名称 Characteristic	符号 Symbol	额定值 Rating	单位 Unit
输入端 Input	正向电流 Forward Current	50	mA
	反向电压 Reverse Voltage	5	V

耗散功率 (单个通道) Power Dissipation (Single channel)		P_M	100	mW
结温 Junction Temperature		T_j	100	°C
工作温度 Operating temp.		T_{aop}	-40 ~ +110	°C
贮存温度 Storage temp.		T_{stg}	-55 ~ +125	°C
焊接温度	手工焊 Hand Soldering (3 Sec.)	T_{sld}	360	°C
	回流焊 Reflow Soldering (5 Sec.)		260	°C
绝缘电压 Isolation voltage (RH≤60%,交流 1 分钟) (RH≤60%, AC 1min.)		V_{ISO}	3750	V_{rms}

6 光电参数 Opto-Electrical Characteristics

表 2 光电参数

Table 2-Opto-Electrical Characteristics

$T_a=25^\circ\text{C}$

参数 Parameters	符号 symbol	测试条件 Test condition	最小值 Min.	典型值 Typ.	最大值 Max.	单位 Unit	
输入 Input	正向电压 Forward Voltage	V_F	$I_F=10\text{mA}$	-	1.35	1.7	V
	反向电流 Reverse Current	I_R	$V_R=5\text{V}$	-	-	10	μA
输出 Output	开路电压 Open Circuit Voltage	V_{oc}	$I_F=10\text{mA}$ $I_o=0\text{mA}$	6.5	7.5	-	V
	短路电流 Short Circuit Current	I_{SC}	$I_F=10\text{mA}$ $V_o=0\text{V}$	6	10	-	μA
传输隔离 特性 Switch specificati on	开启时间 Turn On Time	T_{ON}	$I_F=10\text{mA}$	-	40	-	us
	关断时间 Turn Off Time	T_{OFF}	$I_F=10\text{mA}$	-	50	-	us
	绝缘电压 Isolation voltage	V_{ISO}	$I_{off}\leq 0.3\text{mA}$, AC, 60s	3750	-	-	V

7 外形尺寸及电原理图 Dimensions and Circuit Diagram

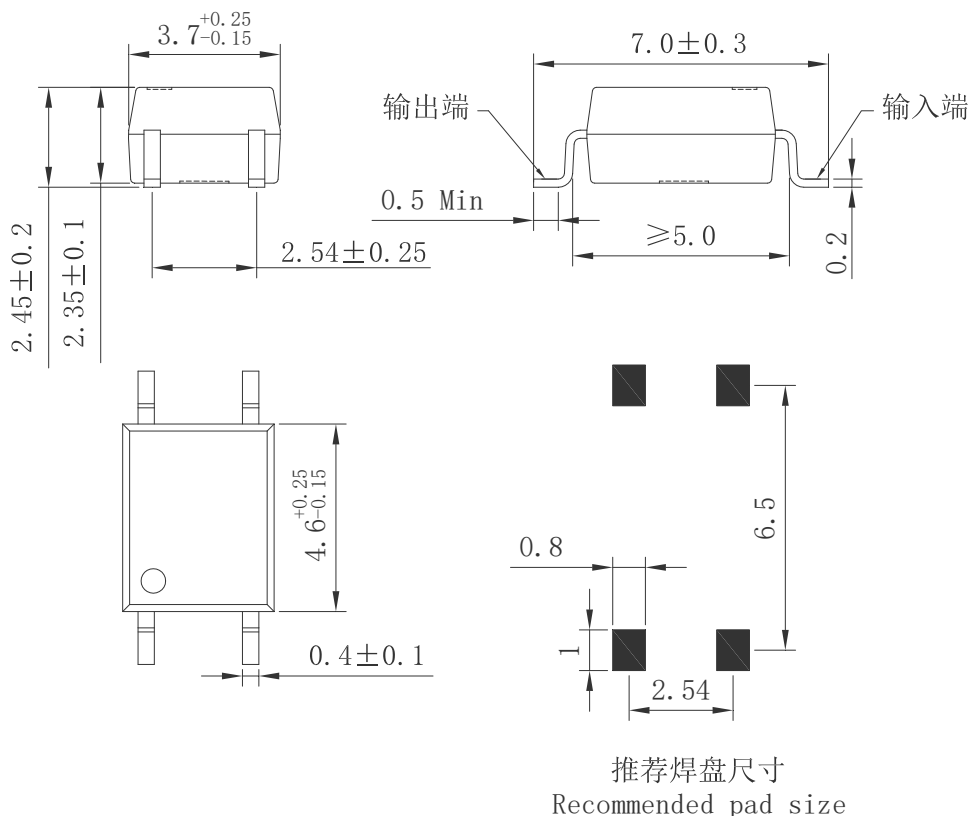


图 4 HPV7A11S 外形尺寸
Figure 4- The dimensions of HPV7A11S

8 标志 Mark

产品上应有型号、公司商标、生产日期代码、引出端识别标记。例如：HPV7A11S 产品印章如图 5。

Print type characters ,trade mark and Lot.No.on the Photo Coupler.For example the marking of product HPV7A11S is shown as figure 5.

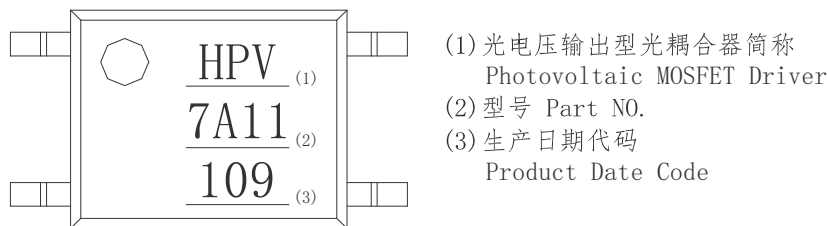


图 5 产品印章
Figure 5- Marking

9 包装方式 Packing

10.1 编带包装 (Tape and reel): 适用于 For HPV7A11S。

10.1.1 每卷数量 (Qty/reel): 3000 只 (pcs)。每箱数量 (Qty/ctn): 60000 只 (pcs)。

10.1.2 内包装 (Inner packing):

每卷盘 3000 只, 贴合格证 (型号、生产日期代号、检验员代号)。

3000pcs/reel, certificate on reel (model, code of product date, Inspector's code)

10.1.3 外包装(Outer packing):

公司名称、地址、商标、产品型号、数量等标志。

Indication of company name, address, trade mark, model and quantity.

10.1.4 示意图 (Schematic):

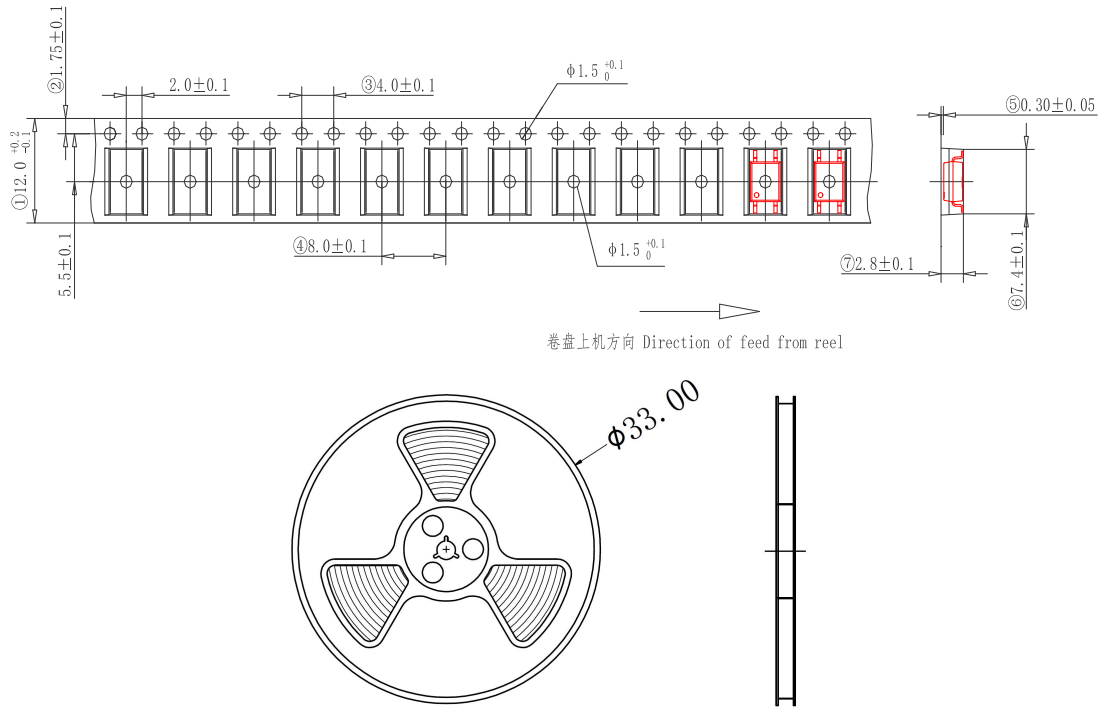


图 6 编带包装示意图

Figure 6- Taping Packing Schematic

10.2 注意事项 Note

10.2.1 推荐贮存温度 Recommend storage Temp.: 0~40°C;

推荐贮存湿度 Recommend storage humidity: <60%;

贮存有效期半年 Storage life: Half of a year.

10.2.2 湿气敏感度等级 1 级。MSL level: MSL 1.

10.3 引脚镀锡厚度: 大于等于 3μm。

Thickness of Sn which plated on lead frame: $\geq 3 \mu\text{m}$.

10.4 推荐焊接条件 Recommended soldering conditions

10.4.1 施加在环氧树脂上的温度不要超过最高贮存温度。

Not to apply high temperature exceeding the maximum storage temperature to the epoxy resin.

10.4.2 在高温下不要对环氧树脂施加压力。

Not to apply any force to the epoxy resin at high temperature.

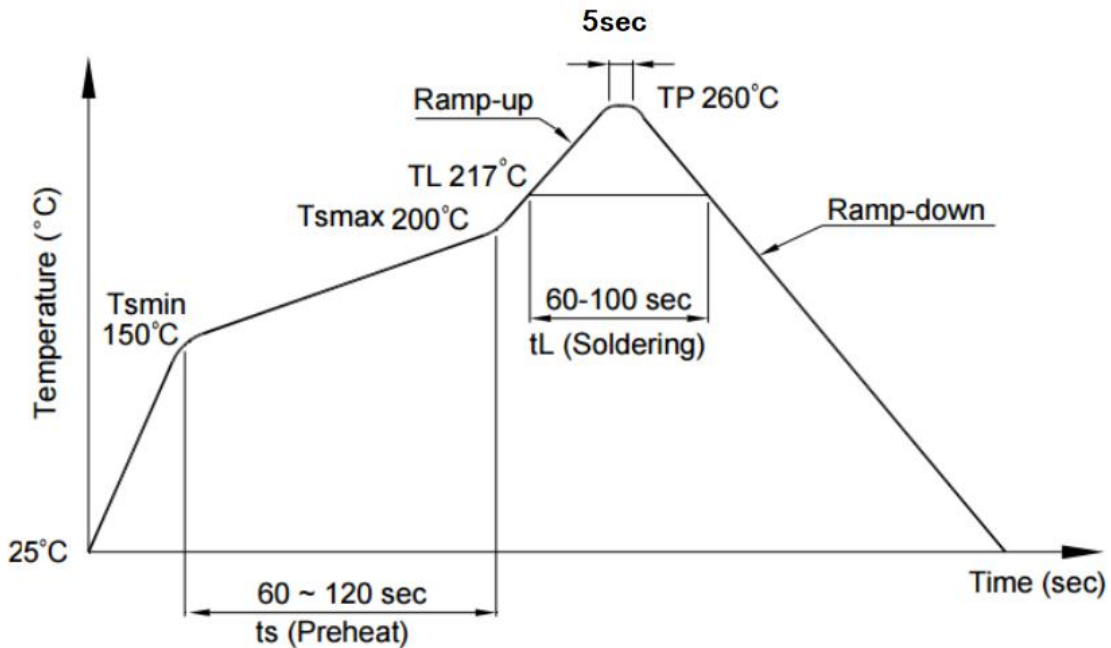
10.4.3 焊接过程 Soldering process

1、在焊接过程中不要对器件施加任何压力。

Not to apply any stress to the component during the soldering process.

2、回流焊 Reflow soldering

- 1) 推荐锡膏规格 Recommend tin glue specifications:
 - a) 熔点 Melting temperature: 217°C
 - b) 组分 Contains: SnAg3Cu0.5
- 2) 回流焊工序必须在器件冷却至室温后进行。Never take next process until the component is cooled down to room temperature after reflow.
- 3) 推荐回流焊接参数，如下图所示： The recommended reflow soldering profile is following:



项目 Items		条件 Conditions
预热 Preheat	Temperature Min (T _{Smin})	150°C
	Temperature Max (T _{Smax})	200°C
	Time (min to max) (t _s)	90±30 sec
焊接区 Soldering zone	Temperature (T _L)	217°C
	Time (t _L)	60 ~100 sec
最高温度 Peak Temperature (T _P)		260°C
升温速率 Ramp-up rate		3°C / sec max.
降温速率 Ramp-down rate		3~6°C / sec

图 7 回流焊参数

Figure 7-Recommended reflow soldering profile

11 产地 Production Place

11.1 产地 Production Place: 中国厦门 Xiamen China;

11.2 工厂名称 Production NO.: 厦门华联电子股份有限公司; Xiamen Hualian Electronics Corp. , Ltd.;

11.3 工厂地址 Production Add.: 厦门市翔安区舩阳南路 189 号 No.189, Fangyang South Road, Xiang' an District, Xiamen China.

更改记录表

Engineering Change Notice-Record

版次 Edition	更改日期 Date	主要更改内容 Main Content	拟制 Prepared	确认 Checked
1.0	2021-08-15	新版发行	黄发宝	段果
1.1	2022-09-05	载带宽度由 16mm 更改为 12mm。	郑清清	段果
1.2	2022-12-30	1. 工厂地址变更、删除邮编； 2. 删除 10.2 标识 Label。	张强龙	黄发宝
1.3	2023-03-17	1. 表 1 工作温度上限由 85℃调整为 110℃；更新焊接温度条件； 2. 表 2 VF 典型值由 1.2V 调整为 1.35V，最大值由 1.3V 调整为 1.7V； 3. 10.2.1 推荐贮存湿度由 <70%调整为 <60% 4. 更新表 7 回流焊参数图；	郑清清	黄发宝